PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-115564

(43)Date of publication of application: 08.05.1989

(51)Int.CI.

B24B 21/00 B24B 21/22

(21)Application number : 62-271829

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

29.10.1987

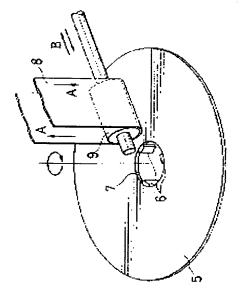
(72)Inventor: NAKAMURA ZENKICHI

MIYAZAWA KUNIO

(54) SURFACE TREATMENT METHOD OF SUBSTRATE FOR MAGNET DISK (57)Abstract:

PURPOSE: To even surface roughness in the circumferential direction of a sub strate from the inner peripheral side to the outer peripheral side by pressing a grinding means against a disklike substrate while shifting said means radially of the substrate and changing the rotational frequency of substrate according to the position of the pressed grinding means.

CONSTITUTION: After a substrate 5 for a magnetic disk is rotated by a motor, a lapping tape 8 bears against one surface of the substrate 5 to be pressed against the substrate 5 by a roller 9. At the same time, the roller 9 is reciprocat ed radially of the substrate 5, while the rotational frequency of substrate 5 is changed according to the position of moved



roller 9. Thus, the circumferential speed of substrate 5 relative to the lapping tape 8 in each radial position is evened from the inner peripheral side to the outer peripheral side of substrate 5. Thus, the surface of substrate 5 for the magnetic disk is ground by the lap ping tape 8 through the whole surface under the same requirement to even the surface roughness of fine irregular portions formed in the circumferential direction.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application

BEST AVAILABLE COPY

...S PAGE BLANK (USPTO)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-115564

@Int_CI_4

識別記号

厅内整理番号

每公開 平成1年(1989)5月8日

B 24 B 21/00 21/22 B-7712-3C 7712-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

磁気ディスク用基板の表面処理方法 49発明の名称

> 願 昭62-271829 创特

願 昭62(1987)10月29日 9出

@発 明 者 村

莾 吉

雄

東京都品川区北品川6丁目5番6号 ソニー・マグネ・ブ

ロダクツ株式会社内

沢 国 母発 明 渚 宮

東京都品川区北品川6丁目5番6号 ソニー・マグネ・ブ

ログクツ株式会社内

ソニー株式会社 の出 願 人

東京都品川区北品川6丁目7番35号

弁理士 小池 晃 外2名 ②代 理 人

細 肉

発明の名称

磁気ディスク用基板の表面処理方法

2. 特許請求の顧囲

円板状の基板に研削手段を押圧し、接基板を回 転させながら表面処理を施すに際し、

前記研削手段を基板の径方向に移動させるとと もに、基板の回転数を上記研削手段の位置に応じ て変化させることを特徴とする磁気ディスク用基 板の表面処理方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、いわゆるハードディスクの支持体で ある磁気ディスク用基板の表面処理方法に関する ものであり、詳細には磁性層形成前に磁気ディス ク用基板に対して行ういわゆるテクスチャリング 処理の改良に関するものである。

(発明の概要)

本発明は、磁気ディスク用基板に表面処理を筋 すに際し、研削手段を上記磁気ディスク用基板に 押圧して径方向に移動させるとともに、基板の関 転数を上記研削手段の位置に応じて変化させるこ とにより、当該研削手段に対する基板の径方向各 位置での周速度を一定にして当該基板の表面相度 を内周側から外周側に亘って均一とするものであ ъ.

〔従来の技術〕

例えばコンピュータ等の記憶媒体としては、ラ ングムアクセスが可能な円板状の磁気ディスクが 広く用いられており、なかでも、応答性に優れる こと、記憶容量が高いこと等から、基板にAl合 金板やガラス板、プラスチック板等の硬質材料を 用いた磁気ディスク、いわゆるハードディスクが 固定ディスク、あるいは外部ディスクとして使用 されるようになっている.

上記ハードディスクは、例えば磁気ディスク用

特開平1-115564(2)

のA & 合金基板上に記録再生に関与する磁性層を 形成したものであって、高速で回転して同心円状 の多数のトラックに情報の記録再生を行うもので ある。

ところで、このような磁気ディスクにあっては、 磁性層形成前の磁気ディスク用基板の表面が微細 な凹凸部を有していることが必要とされる。すな わち上記微細な凹凸部は、磁気ディスクの走行性。 耐久性に大きく関与し、さらには基板上に形成さ れる磁性層の付着力の向上等にも関与するもので あるからである。

この微細な凹凸部を形成する手法としては、テープ体上に低粒が固著されたいわゆるラッピングテープ等による方法や、ポンパード処理等のドライエッチング、さらにはウェットエッチング等の方法が挙げられるが、なかでも処理速度や装置の簡便さ等の観点からラッピングテープを用いて基板の円周方向に微細な凹凸部を形成する方法が一般的に使用されている。

このラッピングテープを用いた磁気ディスク用

面相度は外周部の表面相度く中央部の表面粗度く 内周部の表面粗度となる傾向にある。

ところが、磁気ディスク用基板の表面粗度は、ある一定範囲に設定する必要があり、例えば、表面粗度が上記所定範囲以外であった場合は、走行性、耐久性が大幅に低下することになる。したがって、上述のような従来の表面処理方法では、たとえ内周側の表面粗度が上記所定範囲の粗さとなったとしても、外周側の表面粗度は上記所定範囲の組さにならないことから、ディスクの信頼性、特にCCS特性(コンタクト・スタート・ストップ特性)が外周側に行くにしたがって劣化するという問題が生ずる。

そこで、本発明は上述の実情に鑑みて提案されたものであって、基版の円周方向での表面相度を 内周側から外周側に亘って均一とする磁気ディスク用基板の表面処理方法を提供することを目的と するものである。

(問題点を解決するための手段)

基板の表面処理方法は、例えば第5図に示すように中央に形成されたクランプ孔 1を有する円板状の基板2の表面に、研削手段であるラッピングテープ3を巻回したゴムローラ4を押圧させ、接基板2を回転させながら上記ラッピングテープ3により当該基板2表面上に微細な凹凸部を形成するものである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、一般的に基板2の表面に微細な凹凸部を形成するために使用するラッピングテーブ3は、その幅が上記基板2の磁性層が形成される磁気 別間縁までの距離)よりも長く設定されている。 外間縁までの距離)よりも長く設定されている。 このため、基板2の内周側から外周側に亘って一度に研削が行われることになる。したがって記記 基板2の径方向各位置での周速度は、外周部の周速度となる。 このため、内間側に比べて外間側の方がより高速 で研削されることになり、基板2の円潤方向の曳

本発明は、上記問題を解決するとともに、上記目的を達成するため、円板状の基板に研削手段を押圧し、該基板を回転させながら表面処理を施すに際し、前記研削手段を基板の径方向に移動させるとともに、基板の回転数を上記研削手段の位置に応じて変化させることを特徴とするものである。

(作用)

本発明方法によれば、研削手段を基板の径方向 に移動させるとともに、その移動させる研削手段 の各位置に応じて基板の回転数を変化させるため、 基板の径方向各位置での研削手段に対する周速度 が内周側から外周側に直って均一となる。このた め基板は、全体に亘って同一条件で研削されて表 面相度が均一となる。

(事務例)

以下、本発明を適用した具体的な一実施例について図面を参照しなから説明する。

本実施例は、本発明方法を基板上に磁性層が形

成されてなる磁気ディスクの当該磁性層が形成される前の磁気ディスク用基板の表面処理方法に適用した例である。

先ず、本発明の磁気ディスク用基板の表面処理 方法に用いる基板表面処理装置を第1図乃至第4 図に示し説明する。

上記基板に表面処理を施す基板表面処理装置は、第1図に示すように、磁気ディスク用基板を回転させる回転駆動装置(図示は省略する。)と、基板の表面に微細な凹凸部を形成するための研削手段とからなる。

上記回転駆動装置は、上記磁気ディスク用基板 5 を装着固定させ、当該基板 5 の径方向に回転させるものである。このため回転駆動装置には、上記研気ディスク用基板 5 を固定するための固定治具 6 が設けられており、さらに基板 5 を回転させるためのモータが配設されている。上記固定治理 6 は、基板 5 中央に形成さたクランプ孔 7 に嵌合され、当該基板 5 をこのクランプ孔 7 で固定するものである。また、上記回転駆動装置は、任意に

記ローラ9は、ラッピングテーブ8を均一に基板5の表面に当接させるためゴム等の弾力性に高んだ材料で形成され、その形状は円筒体状とされている。さらに上記ローラ9は、ラッピングテープ8を基板5次面により均一に当接させるため、当該ラッピングテープ8を基板5に対して垂直に所定の圧力で押圧させている。なお、上記円筒体の長し、さは、上記基板5の磁性層が形成される部分の径方向の長さしの1/3~1/2長さとするのが好ましい。

また、上記ローラ9は、第2図および第4図に 示すように、磁気ディスク用基板5の径方向、す なわち内周側から外周側、またはその逆方向(図 中矢印8方向)に移動するようになっている。そ のローラ9の移動距離は、上記ラッピングテープ 8により蒸板5の磁性層が形成される部分が完全 に研削される距離であればよい。また、このロー ラ9の移動に際し、上記ラッピングテープ8の両 端縁8a.8bの位置は、上記移動距離範囲の両 端傾で少なくとも上記番板5の外周縁5aおよび モークの回転数を変化させることができるように なっている。

上記研削手段は、上記磁気ディスク用基板5の 要面に微細な凹凸部を形成するためのラッピング テープ8と、このラッピングテープ8を押圧、移 動させるローラ9とからなる。

上記ラッピングテープ8は、例えばサンドベーパー等のようにシート状の基体上に低粒が固若されたものでその形状は長尺状とされている。また、上記ラッピングテープ8の幅し、は、上記基版5の低性層が形成される部分の径方向の長さし(クランプ孔7の外間録7aから基板5の外間録5aまでの距離)よりも小さくされている。このため、基板5を一度にラッピングテープ8の幅し、よりも大きくても流くても差し支えない。

上記ローラ9は、ラッピングテープ8を破気ディスク用基板5の表面に押圧させ、且つ当該基板5の表面に押圧させ、且つ当該基板5の径方向に移動させるものである。このため上

クランプ孔 7 の外間録 7 a の位置よりも外別側に位置していることが望まれる。さらに、上記ローラ9 は、上記磁気ディスク用基板 5 の径方向に所定の振幅をもって揺動可能となっている。なお、上記ローラ9 の活動は行わなくともよいが、好ましくは揺動させた方がよい。また、前記福動を加える場合には、その揺動数n(回/分)は原則的には基板 5 の周速度に応じて増加させることが好ましいが、この揺動数nには下限があり、また基板 5 の周速度には上限があることから必ずしもこれらに従う必要はない。

このようなローラ9の円筒体の周面には、上述したラッピングテープ8が巻回され、当路円筒体の周方向に沿って回転するようになっている。このため、上記ラッピングテープ8は、上記ローラ9が回転すると第(図中矢印A方向に送られる。したがって、ラッピングテープ8は研削されて近か終り減っても、常に新しいテープ8が送られるので均一に基版5が研削される。なお、本実施例では、上記ラッピングテープ8の送り方向は上

記基板 5 の団転方向と直交する方向とした。

以上のような構成とした基板表面処理装置を用いて破気ディスク用基板の表面を処理するが、以下その処理方法について詳述する。

先ず、基板 5 中央に形成さたクランプ孔 7 を有する円板状の磁気ディスク用基板 5 を前述した回転駆動装置に載置し、次いで、上記クランプ孔 7 を回転駆動装置の固定治具 6 に嵌合させ当該基板 5 を上記固定治具 6 で固定する。

ここで、上記磁気ディスク用 要板 5 の材料としては、A L 板、A L 合金板、N i - P メッキを施したA L 板、A L 合金板、アルマイト処理を施したA L 板、A L 合金板や、ガラス板、プラスチック板等が使用されているが、例えばポリエーテルイミド、ポリカーポネート、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン、ポリアセタール、ポリフェニサルファイド等も用いられる。

次に、回転駆動装置のモークにより上記磁気ディスク用基板5を回転させる。その後、ラッピングテープ8を上記磁気ディスク用基板5の一表面

その表面粗度が#4000のものを使用し、そのテー ブ幅し、を17.5mmとした。そして、このラッピン グテープ8を参勤するローラ9の円筒体の長さし 。は、上記ラッピングテープ8の幅し、と同じく 17.5mgとした。そして、ローラ9の押圧力を1.0 Kgとし、その移動距離は37mmとし、ラッピングテ ープ8の送り速度を毎分110mm とした。その際、 上記ローラ9の移動距離範囲の端部で、上記ラッ ピングテープ8の嫡雄8aからクランプ孔?の外 周縁7 a までの距離を1.5mm に設定した。そして、 上記基板5の径方向各位置に前記ローラ9が達し たときに、各位置での周速度が基板全体に亙って 全て15.7mm/分となるように回転駆動装置の回転 数を変化させ、ローラ9の揺動の張幅を2mmとし て一分間に60回揺動させるとともに、一分間に10 Occ の冷却水を基板 5 表面に注いで冷却しながら 基板5に表面処理を施した。その処理時間は120 抄である。

上述のような方法で基板5に表面処理を施した 後、得られた磁気ディスク用基板5をタリステッ 上に当接させ、ローラ9により当該ラッピングテープ8を基板5に押圧させるとともに上記ローラ9を基板5の内周側から外間側に向かって当該動は所定時間行い、上記基板5の内周側から外周側から外間側が6外間側に往復運動させ、また外間側から内間側に往復運動させる。なお、その際、上記ローラ9を基板5のとして、上記基板5を回転させる回転駆動装置のモータを制御して上記ローラ9の移動位置に応じて当該モータの回転数を変化させながら基板5の裏面処理を行う。

実際、本発明者等は、前述の基板表面処理装置 を用いて磁気ディスク用基板の表面処理を以下の 条件に基づいて行った。

先ず、磁気ディスク用基板 5 には、直径3.75インチでNI-Pメッキが施されたAI合金板を使用した。そしてその基板 5 の磁性層が形成される部分の径方向の長さしを35mmとした。一方、この基板 5 に表面処理を施す ラッピングテーブ 8 は、

プ表面程度計を用いて当該基板 5 の表面程度を測定した。その際、上記基板 5 の表面程度は、JIS 規格(JIS80601) で配数される中心平均相さ R a で表示する。その結果、基板 5 の外周部の表面程度 R a は2.44 an であり、中央部では2.41 nm であり、内周郎では2.43 nm であった。すなわち、上記磁気ディスク用基板 5 の表面は、内周側から外周側に亘って均一な表面程度となった。

これは、周遠度を基板5の内間側から外間側に 亘って均一となるようにそのローラ9の位置に合 わせて当該基板5の四転数を変化させているため、 上記基板5の径方向各位置での内速度が如何なる 位置であっても均一となることによる。したがっ て、上記周速度が一定となれば、基板5全体に亘 で、上記周速度が一定となれば、基板5全体に亘 の内側側がら外間側に重ってなり、当及 変が均一となる。 は、基板5の径方向での揺動効果が均一なものと ながり一となる。 は、基板5の径方向での揺動効果が均一なものと なり、表面租度の均一性はより一層向上する。

特開平1-115564 (5)

(発明の効果)

以上の説明からも明らかなように、研削手段を 研気ディスク用基板の径方向に移動させ、この研 削手段の移動位置に応じて当該磁気ディスク用基 板の回転数を変化させているので、上記基板の径 方向各位置での間速度を内間側から外間側に亘っ て一定とすることができ、内間側から外間側に亘っ って基板表面上の表面相度を均一なものとするこ とができる。したがって、基板面上の如何なる場 所においても走行性、耐久性を確保することがで、 信頼性の高い磁気ディスクの提供が可能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は磁気ディスク用基板の表面処理方法に用いる基板表面処理装置の一例を示す要部機略斜視図である。第2図乃至第4図は基板表面処理装置の概略断面図であり、第2図はローラが基板内周側の端部に位置した状態、第3図はローラが基板中央に位置した状態、第4図はローラが基板外周側の端部に位置した状態をそれぞれ示すもので

ある。第5回は従来の班気ディスク用登板の基板 表面処理装置の要部優略斜視図である。

5・・・磁気ディスク用基板

8 ・・・ラッピングテーア

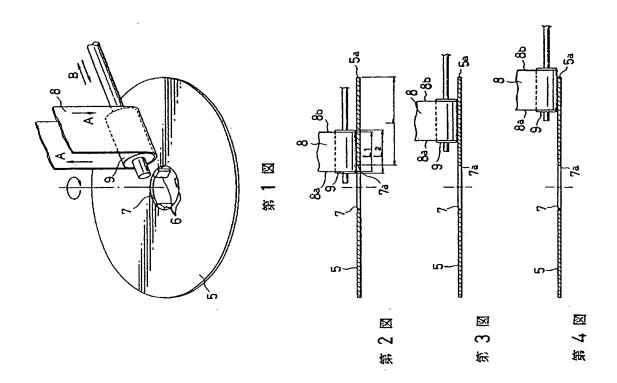
9

 特許出願人
 ソニー株式会社

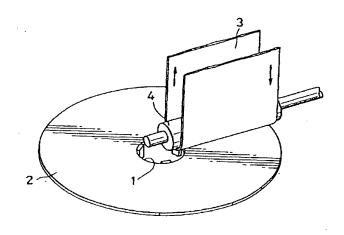
 代理人 弁理士
 小 池 晃

 同
 田 村 榮 一

 同
 佐 野 勝



特開平1-115564 (6)



第5図